附件2：

2020年杭州市集成电路产业发展项目（第一批）

申报材料

材料1：

**杭州市集成电路产业发展项目申报表**

单位名称（公章）：

|  |
| --- |
| **一、单位基本情况** |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法人代表 |  | 企业法人码 |  | 税务登记所在地 |  |
| 职工人数 |  | 研发人员数 |  | 本科人数 |  | 硕士及以上人数 |  |
| 年份 | 主营业务收入 | 其中：集成电路业务收入 | 利 税总 额 | 上交税金 | 利润总额 | 研发资金投 入 | 芯片进口（万美元） |
| 上年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度截至申报日 |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、项目基本情况** |
| 项目名称 |  | 起止时间 |  |
| 项目类型 |  | 联系人 |  | 联系手机 |  |
| 联系人电话 |  | 传 真 |  | QQ号码 |  |
| 总投资及经费构成 |  | 项目进度情况 | 完工项目□实施项目□ |
| 项目简介（300字） |  |
| **三、审核意见** |
| 属地经信部门审核意见：（盖章） 年 月 日 |

**备注：**由申报企业填报材料2：

财政扶持情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称: | 金额：万元 |
|  | 扶持政策类别（国家、省、市专项名称） | 时间 | 项目名称 | 总投资 | 资助额 | 下达资金文件文号 |
| 获得国家、省、市各类财政资助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 企业当前正在申报其他各类财政资助 |  |  |  |  |  | ＊ |
|  |  |  |  |  | ＊ |
|  |  |  |  |  | ＊ |
|  |  |  |  |  | ＊ |
|  |  |  |  |  | ＊ |
|  |  |  |  |  | ＊ |
| 企业承诺 | 本单位承诺：1、上述填列的内容真实完整； |
| 2、本次申报的 项目与上述本单位已获得（申报）的各类财政资助在项目实施内容、投资额等方面不重复； |
| 3、如有不实，本单位愿承担相关责任。 |
|  |
|  法人代表签字： 单位盖章: |
|  |
|  年 月 日 |
|  |
| 注：扶持政策类别按下达资金文件中的类别填写，包括财政资助、奖励、补助等。 |

材料3：

**杭州市集成电路产业发展项目实施报告**

（封面格式）

**项目名称：**

**申报单位（**盖章**）：**

**法定代表人（**签章**）：**

**申报日期：**

**杭州市集成电路产业发展项目实施报告**

（编写提纲）

一、企业概况（500字）

 主要包括企业成立时间、注册资本、经营范围、相关资质、特色优势、行业影响力等。

二、项目特色优势（600字）

1．国内外技术发展现状及趋势；2．国内外市场需求分析；3．项目现有基础及竞争力分析

三、项目实施情况

1．主要实施内容；2．核心技术路线；3．主要技术指标；4．关键创新点；5．主要技术成果

四、项目投资情况

1．总投资及资金来源；2．资金主要用途；3．项目投资明细清单（含印证材料）

五、项目经济和社会效益

1．经济效益分析；2．社会效益分析

六、附件

1．2019年末财务审计报告（含资产负债表、现金流量表、利润表，需加盖申报单位公章）。

1. 项目实际投入**（有效期限为2018年11月1日至2020年3月31日）**的专项审计报告（按杭财企〔2010〕897号执行）。

 **注：2018年、2019年得到集成电路资助的企业，项目验收合格后予以申报。**

3．企业营业执照复印件。

4．相关合同、支付凭证、工资清单和发票复印件，以及其他需要重点说明的项目情况的印证材料。

材料4：

**杭州市集成电路产业发展项目**

**可行性研究报告**

（封面格式）

**项目名称：**

**申报单位（**盖章**）：**

**法定代表人（**签章**）：**

**申报日期：**

**杭州市集成电路产业发展项目**

**可行性研究报告**

（编写提纲）

一、企业概况（500字）

 主要包括企业成立时间、注册资本、经营范围、相关资质、特色优势、行业影响力等。

二、项目必要性及市场前景

1．国内外技术和产品发展现状及趋势

2．国内外市场需求分析

3．项目现有基础及竞争力分析

三、项目概况

1．主要实施内容

2．核心技术路线

3．主要技术指标

4．关键创新点

5．预期项目成果

四、项目投资概算

1．总投资及资金来源

2．资金主要用途

3．专项资金使用计划明细

五、项目的风险分析

主要从技术、市场、政策、人才、资金等方面进行分析。

六、项目的组织实施

1．项目进度安排

2．项目负责人及项目团队情况

3．项目保障措施

七、项目经济和社会效益

1．经济效益分析

2．社会效益分析

八、附件

1．2019年末财务审计报告（含资产负债表、现金流量表、利润表，需加盖申报单位公章）。

1. 项目前期投入**（有效期限2018年11月1日至2020年3月31日，超过计划总投资30%）**的专项审计报告（按杭财企〔2010〕897号执行）。

**注：2019年得到集成电路资助的企业，新项目实际投入从2019年7月1日至2020年3月31日。**

3．企业营业执照复印件。

4．相关合同、支付凭证、工资清单和发票复印件，以及其他需要重点说明的项目情况的印证材料。

材料5：

2020年度杭州市集成电路产业发展推荐项目汇总表

汇总单位（经信部门盖章）：单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报单位 | 所属区县 | 产业领域 | 项目投资额 | 联系人 | 电话 | 手机 | 备注 |
| 企业申报数 | 初审额 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：由区、县（市）及开发区（集聚区）经信局部门填报